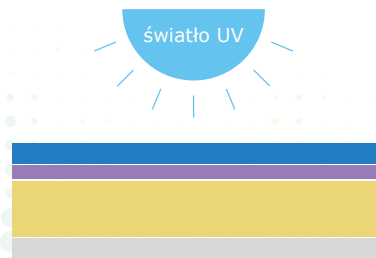


Proces obróbki płyt



INFO
GRA
FIKA

1 Naświetlanie wsteczne



Naświetlanie od strony warstwy podkładowej płyty

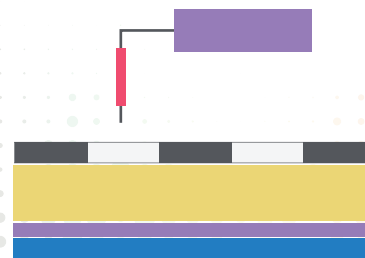
2A Kontakt z negatywem



Zdjęcie folii ochronnej oraz położenie negatywu stroną emulsji na płytę

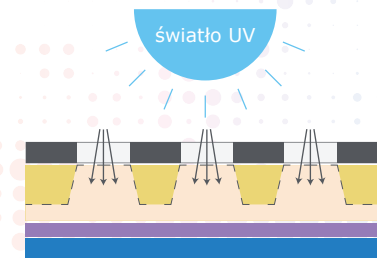
LUB

2B Ablacja, laser CtP



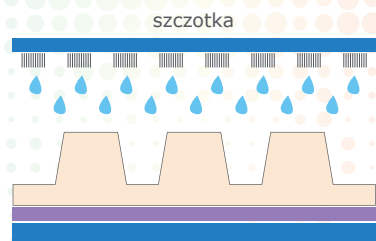
Przeniesienie obrazu cyfrowego z komputera bezpośrednio na powierzchnię maski płyty za pomocą lasera CtP

3 Naświetlanie powierzchni



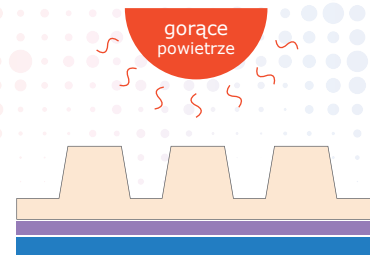
Naświetlanie od strony warstwy podkładowej płyty

4 Wymywanie



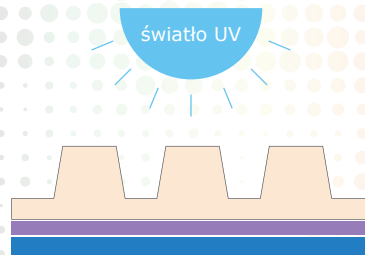
Usuń negatyw i przygotuj płytę w wymywarce.

5 Suszenie



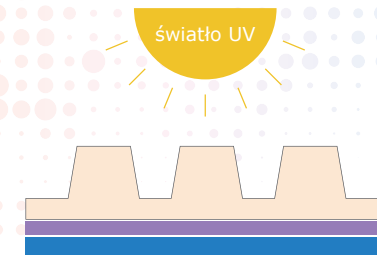
Po wytarciu powierzchni, wysusz w suszarce z gorącym powietrzem.

6 Utwardzanie



Wystaw ponownie na działanie światła UV aby sfinalizować foto-utwardzanie

7 Doświetlanie i utwardzanie



Wystaw na działanie światła UVC aby wyeliminować kleistość z powierzchni płyty